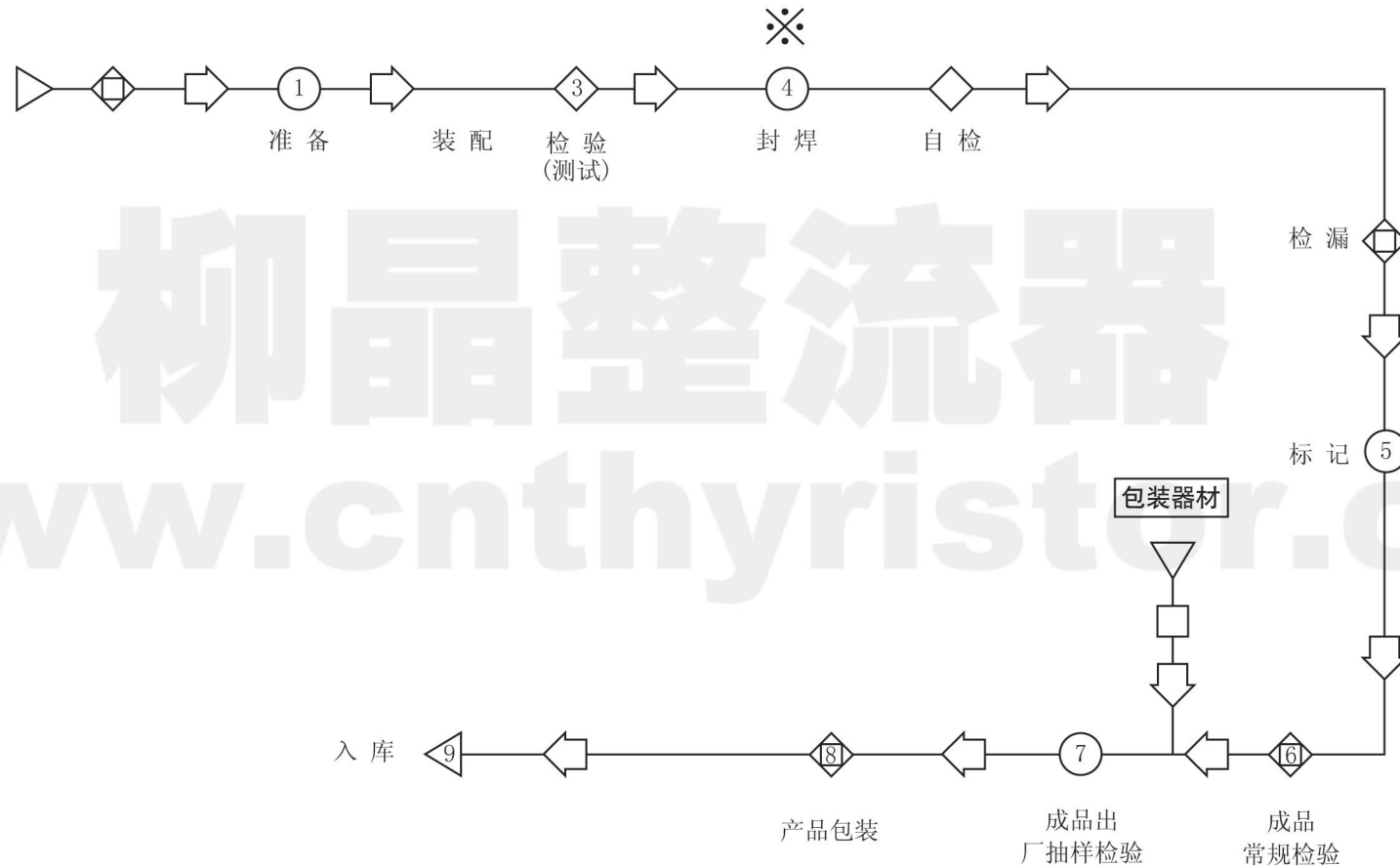


ZP200~ZP500 (平板型) 整流管工艺流程图

组 装 见：  
上封接件  
下封接件  
压 块  
管 芯  
衬 片



注：“※”为关键工序（质控点：本工序如封焊工序参数不能达到要求会造成漏焊，使产品中混入空气会使芯片氧化特把此工序设置为质控点）

描 图

描 校

底 图 号

装 订 号

|        |        |         |        |
|--------|--------|---------|--------|
| 设计(日期) | 审核(日期) | 标准化(日期) | 会签(日期) |
|--------|--------|---------|--------|

|    |    |       |     |     |    |    |       |     |     |
|----|----|-------|-----|-----|----|----|-------|-----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |
|----|----|-------|-----|-----|----|----|-------|-----|-----|